



УКРАЇНА

(19) UA (11) 63163 (13) U
(51) МПК
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/022 (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) МОДУЛЬ ПАРКЕТУ

1

(21) u201103935
(22) 01.04.2011
(24) 26.09.2011
(46) 26.09.2011, Бюл. № 18, 2011 р.
(72) ШУШУЛКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ,
ГРЕБЕНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИР-
ВИЧ
(73) ШУШУЛКОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ,
ГРЕБЕНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИР-
ВИЧ
(57) 1. Модуль паркету, що включає верхній шар
та містить на одній з бічних поверхонь елемент
з'єднання у вигляді паза, який **відрізняється** тим,
що містить додатковий нижній шар, а бічна поверх-
ня, що протилежна поверхні з пазом, додатково
містить елемент з'єднання у вигляді шипа, при
цьому нижня частина елемента з'єднання паз та
верхня частина елемента з'єднання шип вико-
нані із зсувом в протилежні сторони.
2. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим,
що елементи з'єднання при з'єднанні між собою

2

окремих модулів паркету щільно прилягають один
до одного лише в частині верхнього шару, а в ін-
ших частинах виконані з зазором.
3. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим,
що товщина верхнього шару паркетного модуля
становить в діапазоні від 2 до 8 міліметрів.
4. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим,
що товщина нижнього шару паркетного модуля
становить в діапазоні від 8 до 20 міліметрів.
5. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим,
що виступи нижньої частини елемента з'єднання
паз та верхньої частини елемента з'єднання шип
виконані в діапазоні від 15 до 30 міліметрів від
внутрішньої грані паза та від нижньої грані шипа
відповідно.
6. Модуль паркету за п. 5, який **відрізняється** тим,
що виступ верхньої частини елемента з'єднання
шип менше виступу нижньої частини елемента
з'єднання паз на величину зазору.
7. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим,
що верхній шар виконаний з дерева.

Корисна модель належить до елементів
настилення підлог, що складаються з окремих,
подібних один до одного елементів, а саме до мо-
дулів паркету, та може бути використана в сфері
опорядкування підлог приміщень.

При розміщенні та фіксації паркетних модулів
між собою та на підлозі існує проблема необхідно-
сті застосування додаткового проміжного шару між
дерев'яною основою паркету та підлогою, а також
застосування різних клеючих елементів закріплен-
ня, що підвищують вартість матеріалів та час на
встановлення виробу.

Найбільш близьким до запропонованого рі-
шення є відомий модуль паркету (патент України
на корисну модель № 1085 «Модуль паркету»,
опублікований 15.10.2001, Бюл. № 9, 2001 р., вла-
сник патенту: ПП "ІНЕКС УКРПАРКЕТ"), що містить
паркетину з твердолистових порід деревини, на
боковій стороні якої виконано паз та з'єднуючий
елемент, паз виконано вздовж всього периметра
бокової або бокових сторін, а з'єднуючий елемент
являє собою набір планок, що укладені в паз, при

цьому планка має ширину, вдвічі більшу за глиби-
ну паза, і товщину таку, що відповідає ширині па-
за.

Недоліками найбільш близького до запропо-
нованого виробу є: складність з'єднання модулів
між собою, через необхідність застосування окре-
мих елементів, необхідність застосування окремо-
го проміжного шару між підлогою та модулями та
подовжений час монтажу виробів.

Задачею корисної моделі є створення модулів
паркету такими, щоб дозволяли швидке та надійне
з'єднання між собою, не вимагали застосування
окремих додаткових шарів між модулями та підло-
гою та дозволяли виконувати швидкий та надійний
монтаж виробів.

Поставлена задача вирішується запропонова-
ною конструкцією виробу, а саме:

Модуль паркету включає верхній та нижній
шари та містить на одній з бічних поверхонь еле-
мент з'єднання у вигляді паза, а на протилежній
містить елемент з'єднання у вигляді шипа, при
цьому нижня частина елемента з'єднання паз та

(13) U

(11) 63163

(19) UA

верхня частина елемента з'єднання шип виконані із зсувом в протилежні сторони. Елементи з'єднання при з'єднанні між собою окремих модулів паркету щільно прилягають один до одного лише в частині верхнього шару, а в інших частинах виконані з зазором. Товщина верхнього шару паркетного модуля становить в діапазоні від 2 до 8 міліметрів. Товщина нижнього шару паркетного модуля становить в діапазоні від 8 до 20 міліметрів. Виступи нижньої частини елемента з'єднання паз та верхньої частини елемента з'єднання шип виконані в діапазоні від 15 до 30 міліметрів від внутрішньої грані паза. Виступ верхньої частини елемента з'єднання шип менше виступу нижньої частини елемента з'єднання паз на величину зазору. Верхній шар виконаний з дерева.

Корисна модель пояснюється кресленнями, на яких зображено:

Фіг. 1 - Модуль паркету, загальний вигляд, ракурс збоку.

Фіг. 2 - Модуль паркету, з'єднані модулі між собою, закріплення до підлоги, вигляд збоку.

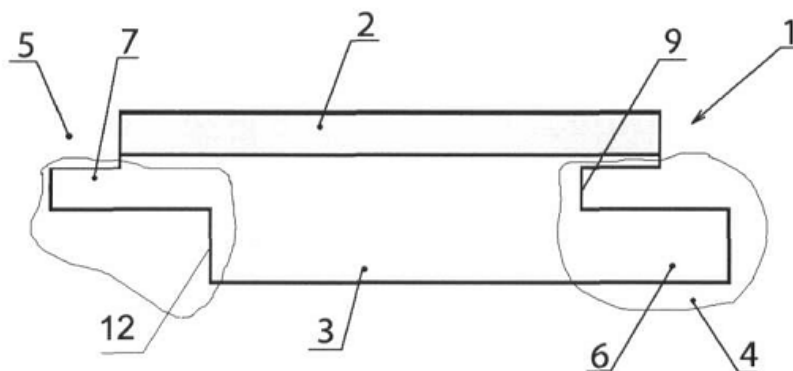
Модуль паркету 1 (фіг. 1) включає верхній 2 та нижній 3 шари та містить на одній з бічних поверхонь елемент з'єднання у вигляді паза 4, а на протилежній містить елемент з'єднання у вигляді шипа 5, при цьому нижня частина 6 елемента з'єднання паз 4 та верхня частина 7 елемента з'єднання шип 5 виконані із зсувом в протилежні сторони. Елементи з'єднання 5 та 6 при з'єднанні між собою окремих модулів паркету щільно прилягають один до одного лише в частині верхнього шару 2, а в інших частинах виконані з зазором 8. Товщина верхнього шару 2 паркетного модуля 1 становить в діапазоні від 2 до 8 міліметрів. Товщина нижнього шару 3 паркетного модуля 1 становить в діапазоні від 8 до 20 міліметрів. Виступи нижньої частини 6 елемента з'єднання паз 4 та

верхньої частини 7 елемента з'єднання шип 5 виконані в діапазоні від 15 до 30 міліметрів від внутрішньої грані 9 паза та від нижньої грані 12 шипа відповідно. Виступ верхньої частини 7 елемента з'єднання шип 5 менше виступу нижньої частини 6 елемента з'єднання паз 4 на величину зазору 8. Верхній шар 2 виконаний з дерева.

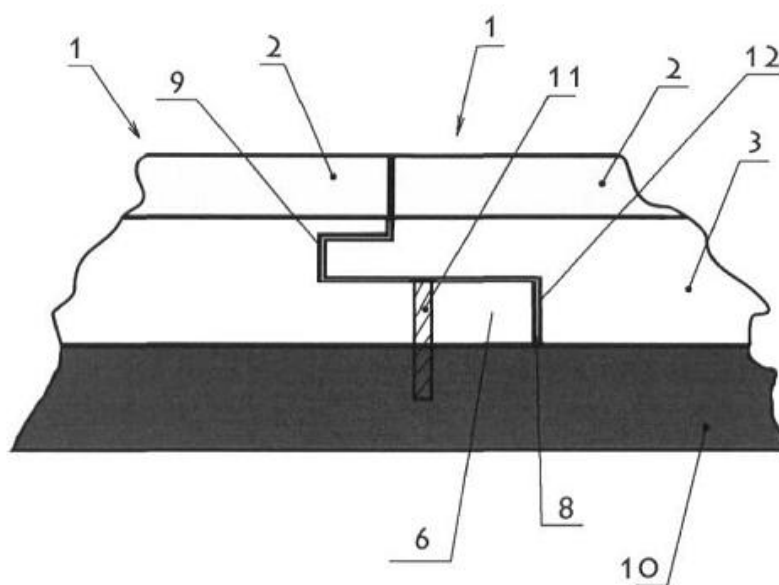
Корисна модель працює наступним чином (фіг. 2):

на підготовлену певним чином підлогу 10, без застосування додаткових проміжних матеріалів між модулями паркету 1 та підлогою 10, розміщують в необхідному порядку готові до монтажу модулі паркету 1. Модулі паркету 1 закріплюють на підлозі шляхом прямої фіксації нижньої частини 6 елемента з'єднання паз 4 елементами закріплення 11 до підлоги 10. Модулі паркету 1 з'єднують між собою шляхом розміщення елемента з'єднання шип 5 одного модуля паркету в елемент з'єднання паз 4 іншого модуля паркету. Виконання модулів таке, що при з'єднанні їх між собою модулі щільно прилягають один до одного лише в частині верхнього шару 2, а в інших частинах виконані з зазором 8. Таким чином монтують поступово всі необхідні модулі паркету 1 на необхідній площі підлоги 10.

Запропонована конструкція модулів паркету дозволяє отримати виріб, який дозволяє швидке та надійне з'єднання елементів між собою та з підлогою. Монтаж не вимагає застосування окремих додаткових проміжних шарів між модулями паркету та підлогою. Дозволяє виконувати швидкий та надійний монтаж виробів, що зменшує час, а як наслідок вартість монтажу, підвищує якість та надійність закріплення паркетних модулів, що вигідно відрізняє запропоноване рішення від існуючих.



Фіг. 1



Фиг. 2